

PUB-NO: EP000557756A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 557756 A1

TITLE: Method for soldering printed circuit boards.

PUBN-DATE: September 1, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
WANDKE, ERNST DR-ING	DE
RIEF, STEFAN DIPL-ING	DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
LINDE AG	DE

APPL-NO: EP93101734

APPL-DATE: February 4, 1993

PRIORITY-DATA: DE04206103A (February 27, 1992)

INT-CL (IPC): B23K001/20, B23K035/38

EUR-CL (EPC): B23K035/38 ; B23K001/20

US-CL-CURRENT: 228/206

ABSTRACT:

The invention relates to a method of soldering assembled printed circuit boards in which a preliminary cleaning step is carried out in which the printed circuit boards are treated with a plasma produced from a process gas. Proposed as a process gas which makes it completely unnecessary to use fluxes in the central soldering step and thus carry out a secondary cleaning step is a gas mixture consisting of 0.5 to 10 % by volume of oxygen 20 to 80 % by volume of hydrogen, and 80 to 20 % by volume of CF₄

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 557 756 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **93101734.7**

(51) Int. Cl.⁵: **B23K 1/20, B23K 35/38**

(22) Anmeldetag: **04.02.93**

(30) Priorität: **27.02.92 DE 4206103**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.09.93 Patentblatt 93/35

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL PT

(71) Anmelder: **Linde Aktiengesellschaft
Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden(DE)**

(72) Erfinder: **Wandke, Ernst, Dr.-Ing.
Isardamm 129a
W-8192 Geretsried(DE)
Erfinder: Rief, Stefan, Dipl.-Ing.
Kirchenstrasse 97
W-8000 München 80(DE)**

(74) Vertreter: **Schaefer, Gerhard, Dr.
Linde Aktiengesellschaft Zentrale
Patentabteilung
D-82049 Höllriegelskreuth (DE)**

(54) **Verfahren zum Verlöten von Leiterplatten.**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verlöten von bestückten Leiterplatten bei dem ein Vorreinigungsschritt ausgeführt wird, bei dem die Leiterplatten mit einem aus einem Prozeßgas erzeugten Plasma behandelt werden. Als Prozeßgas, das die Anwendung von Flußmitteln im zentralen Lötschritt und somit die Durchführung eines nachgeordneten Reinigungsschrittes gänzlich überflüssig macht, wird ein aus

0.5 bis 10 Vol% Sauerstoff,

20 bis 80 Vol% Wasserstoff und

80 bis 20 Vol% CF₄ bestehendes Gasgemisch

vorgeschlagen.

EP 0 557 756 A1

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verlöten von bestückten Leiterplatten mit einem Vorreinigungsschritt, bei dem die Leiterplatten mit einem aus einem Prozeßgas erzeugten Plasma behandelt werden, wobei das Prozeßgas aus O_2 , H_2 , N_2O , Cl_2 , N_2 , Ar, FKW (Fluorkohlenwasserstoffen) oder FCKW (chlorierte Fluorkohlenwasserstoffe) oder Mischgasen davon bestehen kann.

Der Einsatz von elektronischen Baueinheiten, die in Form von Leiterplatten mit einsteckbaren oder oberflächenmontierbaren elektronischen Bauelementen (= Surface Mounted Devices = SMDs), die abschließend zu verlöten sind, gestaltet werden, erfährt einen ständigen Zuwachs. Zur Herstellung dieser Baueinheiten ist die Leiterplatte mit entsprechenden Bauelementen zu bestücken, wobei diese auf irgend eine Weise, z.B. mit einem Klebstoff, vorläufig zu fixieren und - je nach Lötprinzip - gegebenenfalls auch bereits mit einer Lotpaste oder Lot-preforms auf den Lötvorgang vorzubereiten sind. Der im Anschluß daran auszuführende Lötvorgang, bei dem die Verlötung der Bauteilanschlüsse mit den Leiterbahnen der Leiterplatte zu bewirken ist, erfolgt einerseits in bekannter und gängiger Weise mit Wellenlötanlagen, bei denen Lot durch eine oder mehrere, die Leiterplatten von unten berührenden Lotwellen auf entsprechende Bereiche aufgebracht wird. Zum anderen ist bei mit Lotpaste oder Lot-preforms aufgetragenen Bauteilen lediglich ein Aufschmelzen des Lotanteils der Paste oder der Lot-preforms zu bewirken (Reflowlöt).

In beiden Fällen sind allerdings für eine gute Qualität der Lötverbindung Flußmittel anzuwenden. Entweder werden diese im Falle der Wellenlötung vor dem eigentlichen Lötvorgang aufgebracht, oder es enthält die angewendete Lotpaste oder Lotpreform sowohl Lot als auch Flußmittel. Die Flußmittel dienen dem Lötprozeß vor allem insofern, als sie die die Lötung beeinträchtigende Metalloxidschicht auf dem Werkstück zerstören sowie eine Oxidation der beteiligten Metalle beim Lötvorgang verhindern. Zudem wird die Oberflächenspannung des verflüssigten Lots vermindert. Flußmittel sind also multifunktional und dementsprechend aus einer Vielzahl von Substanzen zusammengesetzt. Nach dem Lötvorgang verbleiben jedoch Rückstände der Flußmittel auf den Leiterplatten, die zu nachteiligen Konsequenzen führen. Dazu gehören die Verringerung des Isolationswiderstandes zwischen auf der Leiterplatte befindlichen Leiterbahnen oder die vorschnelle Korrosion der Leiterbahnen. Deshalb sind die Flußmittelrückstände zu entfernen. Dies wird bekanntermaßen durch eine Reinigungsbehandlung der Platten mit FCKWs oder CKWs nach dem Lötvorgang erreicht. Die Anwendung der eben genannten und in bekannter Weise umweltschädigenden Stoffe - FCKW-Ozon-Proble-

matik - soll jedoch heute minimiert oder gänzlich vermieden werden.

In einer neueren Vorgehensweise gemäß der DE-PS 39 36 955 wird die Notwendigkeit der Nachreinigung verursachenden Flußmitteln dadurch herabgesetzt, daß der Verlötung der Platinen eine Niederdruck-Plasma-Behandlung derselben vorgeschaltet wird, wobei das Plasma aus einem Prozeßgas z.B. unter Mikrowellenanwendung erzeugt wird. Als Prozeßgase sind gemäß der besagten DE-PS O_2 , H_2 , Cl_2 , N_2O , N_2 , Ar, FKW oder FCKW oder Kombinationen dieser Stoffe vorgeschlagen. Durch die Behandlung mit einem derartigen Plasma werden der DE-PS zufolge die Oxide an der Leiterplattenoberfläche und insbesondere an den Lötstellen abgetragen und somit die Verlöteigenschaft der Fügeparteen verbessert. Dieser Plasmabehandlung nachfolgend ist dann der Lötvorgang auszuführen, wobei abschließend die nachchemische Nachreinigung der Leiterplatten unterbleiben kann.

Es hat sich jedoch gezeigt, daß bei dem Verfahren gemäß der DE-PS und insbesondere mit der dort angegebenen Prozeßgasmischung mit etwa 83 Vol% CF_4 und 17 Vol% O_2 kein vollständiger Verzicht auf Flußmittel bzw. ähnlich wirkende Hilfsstoffe und demzufolge auf eine entsprechende Nachreinigung möglich ist.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Prozeßgas zur Anwendung bei einer Plasmavorbereitung in einem Lötverfahren anzugeben, welches eine anschließende Lötung ohne den Einsatz von Flußmitteln oder ähnlich wirkenden Hilfsstoffen ermöglicht und welches somit eine Nachreinigung der Leiterplatten von Flußmittelrückständen gänzlich überflüssig macht.

Diese Aufgabe wird mit einem Prozeßgas gelöst, das aus

- 0.5 bis 10 Vol% Sauerstoff,
- 20 bis 80 Vol% Wasserstoff und aus
- 80 bis 20 Vol% CF_4 besteht.

Als besonders effizient hat sich ein Vorreinigungsschritt ergeben, bei dem als Prozeßgas ein Gasgemisch aus

- 2 bis 6 Vol% Sauerstoff,
- 45 bis 55 Vol% Wasserstoff und
- 40 bis 50 Vol% CF_4 verwendet wird.

Mit den erfindungsgemäßen Gasgemischen als Prozeßgas wird nun tatsächlich der vollständige Verzicht auf Flußmittel beim Lötvorgang unter Erhaltung eines hochwertigen Lötergebnis ermöglicht. Die vorgeschlagenen Gasmischungen beruhen auf einer sehr gezielten Auswahl von Gaskomponenten, wobei die Wirkung dahingehend sein mußte, daß diese Gasmischung insbesondere im Plasmazustand sowohl eine Oxidationswirkung als auch eine Reduktionswirkung besitzt. Eben geschilderte Zielsetzung beruht auf der Erkenntnis, daß bei betreffenden Lötvorgängen einerseits auf der Oberfläche

der Leiterplatte sitzende, adsorptiv gebundene oxidierbare Substanzen, z.B. Fette und Öle, entfernt werden müssen und andererseits auch die immer vorhandene, beim Lötvorgang störende Metalloxid-Oberflächenschicht zu beseitigen ist. Diese Aufgaben werden ansonsten durch die zugegebenen Flußmittel gelöst. Erfindungsgemäß gelingt es aber, dies, durch die gezielt zu einem Plasmagas kombinierten Stoffe Sauerstoff, Wasserstoff und Tetrafluorkohlenstoff, in Form einer Plasmavorbehandlung zu bewerkstelligen.

Ein wirksamer und vorteilhafter Plasma-Vorbehandlungsschritt mit dem erfindungsgemäßen Prozeßgas ist ferner dadurch gekennzeichnet, daß er bei einem Druck von weniger als 200 mbar, vorzugsweise 0.5 bis 50 mbar, einer Anregungsleistung einer Mikrowellenquelle von 200 bis 600 Watt und/oder einer Erregerspannung einer Glimmentladung von 200 bis 1000 V, einer Temperatur von 50 bis 200 °C und mit einer Dauer von 30 s bis 5 min durchgeführt wird.

Ein Lötablauf insgesamt kann im übrigen z.B. in der Weise erfolgen, wie dies in der bereits genannten DE-PS 3936 955 geschildert ist. Prinzipiell ist der erfindungsgemäße Vorbehandlungsschritt selbstverständlich in vielen gängigen Lötverfahren anwendbar.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Verlöten von bestückten Leiterplatten bei dem ein Vorreinigungsschritt ausgeführt wird, bei dem die Leiterplatten mit einem aus einem Prozeßgas erzeugten Plasma behandelt werden, wobei das Prozeßgas aus O₂, H₂, N₂O, Cl₂, N₂, Ar, FKW oder FCKW oder Mischungen davon bestehen kann, **dadurch gekennzeichnet, daß als Prozeßgas ein aus**
 - 0.5 bis 10 Vol% Sauerstoff,
 - 20 bis 80 Vol% Wasserstoff und
 - 80 bis 20 Vol% CF₄ bestehendes Gasgemisch verwendet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Prozeßgas ein Gasgemisch aus
 - 2 bis 6 Vol% Sauerstoff,
 - 45 bis 55 Vol% Wasserstoff und
 - 40 bis 50 Vol% CF₄ verwendet wird.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Plasmavorbehandlung bei einem Druck von weniger als 200 mbar, vorzugsweise 0.5 bis 50 mbar, einer Anregungsleistung einer Mikrowellenquelle von 200 bis 600 Watt und/oder einer Erregerspannung einer Glimmentladung von 200 bis 1000 V, einer Temperatur von 50 bis 200 °C und

mit einer Dauer von 30 s bis 5 min durchgeführt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Prozeßgas als fertiges Gasgemisch in Speicherbehältern bereitgestellt wird.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 93 10 1734

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y	EP-A-0 427 020 (WLS KARL-HEINZ GRASMANN WEICHLÖTANLAGEN- UND SERVICE) * Ansprüche 2,4,7 *	1-3	B23K1/20 B23K35/38
D	& DE-A-3 936 955 (WLS KARL-HEINZ GRASMANN WEICHLÖTANLAGEN- UND SERVICE) ---		
Y	EP-A-0 047 663 (HITACHI, LTD.) * Seite 11, Zeile 28 - Seite 12, Zeile 7; Abbildung 2 *	1-3	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 235 (E-766)30. Mai 1989 & JP-10 41 218 (NEC CORP) 13. Februar 1989 * Zusammenfassung *	1,2	
A	US-A-4 699 689 (RICHARD L. BERSIN) ---		
A	EP-A-0 371 693 (PLESSEY OVERSEAS LIMITED) -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			B23K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenart DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 08 JUNI 1993	Prüfer RAUSCH R.G.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPD FORM 1503/03.92 (P04/93)